

产品规格书/Specification

产品/product:	导电银浆/ Electronic paste
料号/Part number:	ST01H-001

适用范围/Application:

此产品适用于氧化铝陶瓷类产品电极使用

Suitable for Alumina ceramic products、thick film circuit electrode.

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	氧化铝陶瓷 Alumina ceramic
印刷 Printing	200-300 目丝网印刷 200-300 mesh stainless screen
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 （空考温度低于 300℃，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150℃ 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉空气气氛下烧结，峰值 850±10℃（推荐值），9-11 分钟。 （可根据实际需要，烧结范围可在 780-850℃内调节,但峰值温度时间必须 10 分钟。） Atmospheric firing in belt furnace with peak time of 9-11 Minutes at 850±10℃
Thinner	ST-1000

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤5μm	FOG test
2 Viscosity	80-280Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT（博利飞）粘度计， 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。

2. 烧结后特性/Characteristics after firing:

在 1 烧结条件下，膜厚 8-12μm Check fired film produced under the conditions specified in 1), (Film thickness is 8-12μm.)



特性 Characteristics		Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
3	Resistivity 方阻	$\leq 6\text{m}\Omega/\square$	Test pattern 0.6mm×60mm 测试图形 0.6mm×60mm
4	Adhesion strength 附着力		Peel Test: 0.5mm ϕ Tin plated Cu wire soldered on 2mm×2mm Pad. 0.5mm ϕ 锡浸铜线，焊接面积 2mm×2mm Solder: 96.5Sn/0.5Cu Mildly activated flux used. 焊料：96.5Sn/0.5Cu
	Initial 初始附着力	$\geq 43.2\text{N}$	
	Ageing 老化附着力	$\geq 24.6\text{N}$	Ageing: 150°C×24hrs 老化条件：150°C，24 小时

保存条件，有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25°C 的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25°C

包装方式/Packaging method:

标准包装，1000g/罐，样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.